



<b>Title of Change:</b>	uDFN/uQFN Back End Site and Material Change.		
<b>Proposed First Ship date:</b>	17 Mar 2020 or earlier if approved by customer		
<b>Contact Information:</b>	Contact your local ON Semiconductor Sales Office or < <a href="mailto:logic.fpcn@onsemi.com">logic.fpcn@onsemi.com</a> >		
<b>PCN Samples Contact:</b>	Contact your local ON Semiconductor Sales Office or < <a href="mailto:PCN.samples@onsemi.com">PCN.samples@onsemi.com</a> >. Sample requests are to be submitted no later than 30 days from the date of first notification, Initial PCN or Final PCN, for this change. Samples delivery timing will be subject to request date, sample quantity and special customer packing/label requirements.		
<b>Additional Reliability Data:</b>	Contact your local ON Semiconductor Sales Office or < <a href="mailto:Phine.Guevarra@onsemi.com">Phine.Guevarra@onsemi.com</a> >		
<b>Type of Notification:</b>	This is a Final Product/Process Change Notification (FPCN) sent to customers. FPCNs are issued 90 days prior to implementation of the change. ON Semiconductor will consider this change accepted, unless an inquiry is made in writing within 30 days of delivery of this notice. To do so, contact <a href="mailto:PCN.Support@onsemi.com">PCN.Support@onsemi.com</a>		
<b>Marking of Parts/ Traceability of Change:</b>	Existing plant code is R and new plant code is S		
<b>Change Category:</b>	Assembly Change, Test Change		
<b>Change Sub-Category(s):</b>	Manufacturing Site Addition		
<b>Sites Affected:</b>			
<b>ON Semiconductor Sites</b>		<b>External Foundry/Subcon Sites</b>	
None		STARS Microelectronics, Thailand	
<b>Description and Purpose:</b>			
A new Subcon site was qualified to increase back end capacity. There is no change in form, fit and function except the marking of plant code.			
Materials change for before and after are stated in below table.			
<b>Material to be changed</b>	<b>Before Change (Existing flow)</b>	<b>After Change (new flow)</b>	
<b>Assy Site</b>	ON Seremban Malaysia	ON Seremban Malaysia	Subcon Thailand
<b>Mold Compound</b>	SU EMEG760	SU EMEG760	MOLDING COMPOUND; G700LTD
<b>Lead frame</b>	LF PPF	LF PPF	LF PPF+RT-UPG
<b>Die Attach</b>	DA AB 8006NS 10CC	DA AB 8006NS 10CC	NON-CONDUCTIVE DIE ATTACH FILM; HR-5104
	<b>From</b>	<b>To</b>	
<b>Product marking change</b>	No change in marking style, plant code is R	No change in marking style, new plant code is S and R.	

**Reliability Data Summary:****QV DEVICE NAME:** NLAS2750MUTAG**RMS** : S54067**PACKAGE** : UQFN10

Test	Specification	Condition	Interval	Results
HTOL	JESD22-A108	Ta= 125°C	1008hrs	0/80
HTSL	JESD22-A103	Ta= 150°C	1008hrs	0/80
TC	JESD22-A104	Ta= -65°C to + 150°C	1000cyc	0/80
HAST	JESD22-A110	130°C, 85% RH, 18.8psig, bias	96 hrs	0/80
uHAST	JESD22-A118	130°C, 85% RH, 18.8psig, unbiased	96 hrs	0/80
PC	J-STD-020 JESD-A113	MSL 1 @ 260°C		0/240
SD	JSTD002	Ta = 245C, 10 sec		0/ 15
RSH	JESD22- B106	Ta = 265C, 10 sec		0/30
PD	JESD22-B102 JESD22-B108	Case Outline		0/15

**QV DEVICE NAME:** MC74LCX245MNTWG**RMS** : S45208 ; S52475**PACKAGE** : QFN 20

Test	Specification	Condition	Interval	Results
HTOL	JESD22-A108	Ta= 125°C	2016 hrs	0/80
HTSL	JESD22-A103	Ta= 150°C	2016 hrs	0/80
TC	JESD22-A104	Ta= -65°C to + 150°C	1000 cyc	0/80
HAST	JESD22-A110	130°C, 85% RH, 18.8psig, bias	96 hrs	0/80
uHAST	JESD22-A118	130°C, 85% RH, 18.8psig, unbiased	96 hrs	0/80
PC	J-STD-020 JESD-A113	MSL 1 @ 260°C		0/240
RSH	JESD22- B106	Ta = 265C, 10 sec		0/15
SD	JSTD002	Ta = 245C, 10 sec		0/ 10

**QV DEVICE NAME:** NLSV8T244MUTAG**RMS** : S49444**PACKAGE** : uDFN 20

Test	Specification	Condition	Interval	Results
HTOL	JESD22-A108	Ta= 125°C	2016 hrs	0/80
HTSL	JESD22-A103	Ta= 150°C	2016 hrs	0/80
TC	JESD22-A104	Ta= -65°C to + 150°C	1000 cyc	0/80
HAST	JESD22-A110	130°C, 85% RH, 18.8psig, bias	96 hrs	0/80
uHAST	JESD22-A118	130°C, 85% RH, 18.8psig, unbiased	96 hrs	0/80
PC	J-STD-020 JESD-A113	MSL 1 @ 260°C		0/240
RSH	JESD22- B106	Ta = 265C, 10 sec		0/15
SD	JSTD002	Ta = 245C, 10 sec		0/ 10



**Electrical Characteristics Summary:**

No impact on electrical characteristics.

**List of Affected Parts:**

*Note: Only the standard (off the shelf) part numbers are listed in the parts list. Any custom parts affected by this PCN are shown in the customer specific PCN addendum in the PCN email notification, or on the PCN Customized Portal.*

Part Number	Qualification Vehicle
NLA2750MUTAG	NLA2750MUTAG MC74LCX245MNTWG NLSV8T244MUTAG

Japanese translation of the notification starts here.  
通知の日本語訳はここから始まります。

*Note: The Japanese version is for reference only. In case of any differences between the English and Japanese version, the English version shall control.*

注：日本語版は参照用です。英語版と日本語版の違いがある場合は、英語版が優先されます。



## 最終製品 / プロセス変更通知

文書番号# : FPCN22186XA

発行日: 10 Dec 2019

変更件名:	uDFN/uQFN 後工程と材料の変更.		
初回出荷予定日:	17 Mar 2020 またはお客様からの承認が得られた場合はそれ以前.		
連絡先情報:	現地のオン・セミコンダクター営業所または <logic.fpcn@onsemi.com> にお問い合わせください.		
サンプル:	現地のオン・セミコンダクター営業所または <PCN.Samples@onsemi.com> にお問い合わせください。 サンプルは、この変更の初回通知、初回 PCN の日付から 30 日以内に要求してください。 サンプル納入時は、依頼日、数量、特別梱包材/ラベル条件によって異なります。		
追加の信頼性データ:	お客さまの地域のオン・セミコンダクター営業所または <Phine.Guevarra@onsemi.com> にお問い合わせください.		
通知種別:	これは、お客様宛の最終製品 / プロセス変更通知 (FPCN) です。FPCN は、変更実施の 90 日前に発行されます。 オン・セミコンダクターは、この通知の送付から 30 日以内に書面による問い合わせがない限り、この変更が承諾されたものとみなします。お問い合わせは、<PCN.Support@onsemi.com> 宛てにお願いします。		
変更部品の識別:	既存の工場コードは R で、新しい工場コードは S です。		
変更カテゴリ:	アセンブリの変更, 検査の変更		
変更サブカテゴリ:	製造拠点の追加		
影響を受ける拠点:			
オン・セミコンダクター拠点:	外部製造工場 / 下請業者拠点:		
無し	STARS Microelectronics, Thailand		
説明および目的:	<p>後工程の生産能力を拡大するために、新しい外注工場が認定されました。工場コードのマーキングを除いて、製品の形状、適合性、機能に変更はありません。</p> <p>変更前および変更後の製品材料については以下の表を参照してください。</p>		
	材料	変更前の表記	変更後の表記
	組立拠点	ON Seremban Malaysia	ON Seremban Malaysia Subcon Thailand
	モールド・コンパウンド	SU EMEG760	SU EMEG760 MOLDING COMPOUND; G700LTD
	リードフレーム	LF PPF	LF PPF LF PPF+RT-UPG
	ダイ接着剤	DA AB 8006NS 10CC	DA AB 8006NS 10CC NON-CONDUCTIVE DIE ATTACH FILM; HR-5104
		変更前	変更後
	製品マーキング変更	マーキングスタイルに変更はありません。 工場コードは R です。	マーキングスタイルに変更はありません。新しい工場 コードは S と R です。



## 信頼性データの要約:

デバイス名: NLAS2750MUTAG

RMS : S54067

パッケージ: UQFN10

テスト	仕様	条件	間隔	結果
HTOL	JESD22-A108	Ta= 125°C	1008hrs	0/80
HTSL	JESD22-A103	Ta= 150°C	1008hrs	0/80
TC	JESD22-A104	Ta= -65°C to + 150°C	1000cyc	0/80
HAST	JESD22-A110	130°C, 85% RH, 18.8psig, bias	96 hrs	0/80
uHAST	JESD22-A118	130°C, 85% RH, 18.8psig, unbiased	96 hrs	0/80
PC	J-STD-020 JESD-A113	MSL 1 @ 260°C		0/240
SD	JSTD002	Ta = 245C, 10 sec		0/ 15
RSH	JESD22- B106	Ta = 265C, 10 sec		0/30
PD	JESD22-B102 JESD22-B108	Case Outline		0/15

デバイス名: MC74LCX245MNTWG

RMS : S45208 ; S52475

パッケージ: QFN 20

テスト	仕様	条件	間隔	結果
HTOL	JESD22-A108	Ta= 125°C	2016 hrs	0/80
HTSL	JESD22-A103	Ta= 150°C	2016 hrs	0/80
TC	JESD22-A104	Ta= -65°C to + 150°C	1000 cyc	0/80
HAST	JESD22-A110	130°C, 85% RH, 18.8psig, bias	96 hrs	0/80
uHAST	JESD22-A118	130°C, 85% RH, 18.8psig, unbiased	96 hrs	0/80
PC	J-STD-020 JESD-A113	MSL 1 @ 260°C		0/240
RSH	JESD22- B106	Ta = 265C, 10 sec		0/15
SD	JSTD002	Ta = 245C, 10 sec		0/ 10

デバイス名: NLSV8T244MUTAG

RMS : S49444

パッケージ: uDFN 20

テスト	仕様	条件	間隔	結果
HTOL	JESD22-A108	Ta= 125°C	2016 hrs	0/80
HTSL	JESD22-A103	Ta= 150°C	2016 hrs	0/80
TC	JESD22-A104	Ta= -65°C to + 150°C	1000 cyc	0/80
HAST	JESD22-A110	130°C, 85% RH, 18.8psig, bias	96 hrs	0/80
uHAST	JESD22-A118	130°C, 85% RH, 18.8psig, unbiased	96 hrs	0/80
PC	J-STD-020 JESD-A113	MSL 1 @ 260°C		0/240
RSH	JESD22- B106	Ta = 265C, 10 sec		0/15
SD	JSTD002	Ta = 245C, 10 sec		0/ 10

**最終製品 / プロセス変更通知**

文書番号# : FPCN22186XA

発行日: 10 Dec 2019

**電気的特性の要約:**

電気的特性への影響はありません。

**影響を受ける部品の一覧:**

注: 部品一覧には標準部品番号 (既製品) のみが記載されています。本 PCN の影響を受けるカスタム部品番号は、PCN メールで提供される顧客個別の付録、または PCN カスタマイズポータルに記載されています。

部品番号	認定試験用ピークル
NLAS2750MUTAG	NLAS2750MUTAG MC74LCX245MNTWG NLSV8T244MUTAG